

LCP 日本住友化学 E6808LHF-BZ

11419KE1连接器专用LCP塑胶原料了解详情

产品名称	LCP 日本住友化学 E6808LHF-BZ 11419KE1连接器专用LCP塑胶原料了解详情
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

EEK目前已广泛成熟应用于航天航空、军工、医疗、电子半导体、汽车、石油石化、分析仪器、饮料灌装、电子烟等使用工况和要求苛刻的高端领域，市场需求潜力巨大。

聚甲醛在汽车工业中的应用量较大。用聚甲醛制作的零件具有减少润滑点、耐磨、便于维修、简化结构、提升效率、降低成本、节约铜材等良好效果。聚甲醛在汽车行业方面用来制造汽车泵、汽化器、输油管、动力阀、万向节轴承、刹车衬套、车窗升降器、安全带扣、门把手、门锁等。在重型汽车中聚甲醛用于制造滑块、负荷指示器外齿轮、钢板弹簧减震衬套、推力杆球座等。代替铜制作汽车上的半轴、行星齿轮等不但节约了铜，而且提升了使用寿命。在发动机燃油系统，聚甲醛可以制造散热器水管阀门、散热器箱盖、冷却液的备用箱、水阀体、燃料油箱盖、水本叶轮、气化器壳体、油门踏板等零件。

ADMER QF300E是一种马来酸酐接枝、均聚聚丙烯（homo PP）基胶粘剂树脂，在与PP和PA的流延膜应用中具有良好的加工性能。

ADMER QE800E是一种马来酸酐接枝的高纯度聚丙烯浓缩物，于PP、EVOH、PA、木材、纸张和玻璃纤维的化合物中用作偶联剂和相容剂。添加到基体聚合物中，可改善木塑复合材料、阻燃电线电缆化合物和注塑件的机械性能。

绝缘材料：PEEK因具有优良的电气性能，在高温、高湿等恶劣条件下，聚醚醚酮的绝缘性能仍能保持，是理想的电绝缘材料，特别是在半导体工业中得到广泛应用。

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上，塑料端子壳的耐焊接温度只有200度左右，由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性，现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

聚甲醛是一种无侧链高密度结晶性聚合物，具有优异的综合性能。

良好的加工性 各种塑料制品都是由熔融塑料用成型机成型的，由于树脂的熔点都较低，易于熔融，将熔料注入模具中，在很短的时间内即可制成形状复杂，尺寸稳定、质量优良的塑料制品。

由于塑料产品要与颜色配合,因此塑胶原材料可分为:抽粒料,色粉料,色种料,还有近期出现的加液体在塑胶原材料中着色.抽粒原料是已经把颜料混合进原料中,每一粒塑料料均已着色,所以形成产品颜色稳定均匀.色粉料及色种料是把色种或色粉混合原料使用,成本低,而且不用储存大量的有色原料.但是颜色不稳定,较难在生产中控制统一性。

具有良好的物理、机械和化学性能，尤其是有优异的耐摩擦性能。

LCP塑胶原料已经用于微波炉容器，可以耐高低温。LCP还可以做印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件；用于电子电气和汽车机械零件或部件；还可以用于医疗方面。

一般增强塑胶原材料力学性能是各项异性的;

LCP塑胶原料全称LIQUID CRYSTAL POLYMER，中文名称液晶聚合物。

有些塑料是可燃的;

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。